



各位

平成27年2月6日

会社名 株式会社 デ イ ス コ
 代表者名 代表取締役 溝 呂 木 斉
 会 長
 (コード番号 6 1 4 6 東証第一部)
 問合せ先 I R 室 長 小 澤 伸 一 郎
 (TEL 03-4590-1111 (代表))

業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ

最近の動向等を踏まえ、平成26年11月6日公表した業績予想および配当予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

業績予想の修正について

平成27年3月通期連結業績予想数値の修正
 (平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日)

(金額の単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益 (円 銭)
前 回 発 表 予 想 (A)	119,500	23,200	23,400	17,200	504.92
今 回 発 表 予 想 (B)	120,600	25,200	24,700	18,200	511.31
増 減 額 (B-A)	1,100	2,000	1,300	1,000	
増 減 率 (%)	0.9	8.6	5.6	5.8	
(ご参考) 前期実績 (平成26年3月期)	104,920	17,353	17,447	12,088	357.55

平成27年3月通期個別業績予想数値の修正
 (平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日)

(金額の単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益 (円 銭)
前 回 発 表 予 想 (A)	101,700	17,200	20,000	14,400	422.73
今 回 発 表 予 想 (B)	103,100	19,200	22,000	15,900	446.69
増 減 額 (B-A)	1,400	2,000	2,000	1,500	
増 減 率 (%)	1.4	11.6	10.0	10.4	
(ご参考) 前期実績 (平成26年3月期)	85,696	11,801	14,637	10,708	316.71

修正の理由

当社が事業展開している半導体・電子部品業界の市場環境と直近の業績動向等を踏まえて当社グループの業績予測を精査した結果、平成27年3月期の業績見通しを修正いたしました。

(注) 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

(裏面へ続く)

配当予想の修正について

修正の内容

(金額の単位:円)

	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回予想 (A)	-	-	-	55	127
今回修正予想 (B)	-	-	-	60	132
当期実績	-	72	-		
(ご参考) 前期実績 (平成26年3月期)	-	50	-	40	90

配当予想修正の理由

今年度の通期業績予想の変更に伴い、当社の配当政策を適用した結果、配当予想を上記の通り修正いたします。

※当社配当政策について:

当社は、株主の皆様への利益還元重視の姿勢を明確にするため、配当政策は業績連動型で「連結半期純利益の25%」としております。ただし利益水準に関わらず、安定配当として、半期10円（年20円）の配当金を維持いたします。

また、赤字の場合を除き、配当及び法人税等支払い後の現預金残高が技術資源購入予備資金及び設備拡張資金、有利子負債返済資金等の予定必要資金額を超過した場合は、超過金額の3分の1を目処に配当として上乘せいたします。
なお、3期連続で連結純利益が赤字になった場合は上記、安定配当の20円を見直しする可能性がございます。

以上